

Doc.No : NR010601

2001年6月1日

平面型レーザープロッターの最新機「フラットラスターFR-7200」を発売 ～大型フォトマスクを高速・高精度に描画～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：石田 明)は、フラットパネルディスプレイやプリント基板などの電子部品業界向けに、大サイズフォトマスクをスピーディーに描画する平面型レーザープロッターの新鋭機「フラットラスターFR-7200」を開発、6月6日から販売します。

このたび発売する「FR-7200」は、需要が著しく増加する液晶やプラズマなどの平面ディスプレイをはじめ、多ピンIC用リードフレーム、高密度プリント基板などの製造に用いる大型フォトマスクを描画する平面レーザープロッターです。ますます微細化、大型サイズ化が進むマスクを高速・高精度に描画するために、独自の分割ラスター描画方式に加え、往復描画と8チャンネルビームの採用により大幅な高速描画(当社比)を実現しました。さらに高出力レーザーの採用により、クロムマスク用のネガレジスト乾板にも高精度に描画できます。

なお、6月6日から東京・有明ビッグサイトで開催されるJPCA2001展に出展します。

< 国内標準販売価格(消費税別)>

2億5,000万円

< 年間販売台数(初年度)>

5台



フラットラスターFR-7200

この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロード
できます。

(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目

特長

1. 従来のエマルジョン乾板に加え、高出力レーザーの採用により、クロムマスク用ネガレジスト乾板にも対応。高品質なマスクを高精度に描画。
2. 高速スキャンタイプの音響光学偏向素子を用いた分割ラスタ走査方式に加え、8チャンネルビームによる往復描画により、マスクパターンを高速描画。例えば600 × 500 mmのエリアの場合、描画時間はわずか17分（描画ピッチ0.5 μmの場合）と従来装置の約2倍の高速化を実現。
3. 描画ピッチは0.125 μm / 0.25 μm / 0.5 μmと、最大3段階の切り替えが可能。ラフパターンは高速に、微細パターンは高画質で、乾板ごとに最適パターン描画を実現。
4. 光源にはLD励起YAGレーザーを採用。長寿命で交換も簡単に行なえ、装置のダウンタイムを大幅に削減。
5. サーマルチャンバーを標準装備し、対環境安定性も万全。内部は温度±0.1℃で制御し、クリーン度はクラス100相当。
6. 描画機本体の診断ソフトや調整ソフトにより、システムの状態管理も容易。
7. オプションのオートローダー搭載により、15枚連続描画が可能。

仕様

媒体	: ネットワーク(IEEE802.3/Ethernet)
フォーマット	: RS27D準拠ガーバードアドレス バイナリフォーマット(VAPE含む)
最大有効描画サイズ	: 800 × 700 mm
最大乾板サイズ	: 32 × 28 インチ
感材	: リス、ラス、ハイレゾガラス乾板、クロムマスク用ネガレジスト乾板
描画ピッチ	: 0.5 μm / 0.25 μm / 0.125 μm 切り替え可能
機械位置決め精度	: ±(1 + 3L/800) μm (3 μm) (0.25 μmピッチ時)
描画位置再現性	: ±1 μm (3 μm) (0.25 μmピッチ時)
線幅精度	: 0 ~ +2 μm (0.25 μmピッチ時)
描画時間*	: 約17分(0.5 μmピッチ時) 約44分(0.25 μmピッチ時) 約150分(0.125 μmピッチ時)

* 描画エリア = 600 × 500 mmの場合